



Title of Change:	Addition of package substrate vendor UMTC for iBGA package at Kingpak.	
Effective date:	08 Aug 2020	
Contact information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Geethakrishnan.Narasimhan@onsemi.com	
Type of notification:	This Product Bulletin is for notification purposes only. ON Semiconductor will proceed with implementation of this change upon publication of this Product Bulletin.	
Change Category:	Assembly Change	
Change Sub-Category(s):	Alternative supplier for package substrates	
Sites Affected:		
ON Semiconductor Sites		External Foundry/Subcon Sites
None		Kingpak, Taiwan
Description and Purpose: ON Semiconductor Intelligent Sensing Group is adding a package substrate source for our iBGA offering from KingPak. This substrate is identical in design, materials and construction to the existing substrate and will be sourced from UMTC. UMTC is an approved supplier of substrates to ON Semiconductor and is a qualified supplier for automotive. The change does not influence the integrity of the final product.		
List of Affected Standard Parts: <i>Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the <u>PCN Customized Portal</u>.</i>		
AR0132AT6R00XPEA0-DRBR1	AR0132AT6G00XPEA0-AA-DRBR	ASX350AT3C00XPEA0-DR1
ARX550AT2C00XPEA0-DRBR	AR0136AT3C00XUEA0-DRBR	AR0144ATSM20XUEA0-DRBR
MT9M034I12STC-DRBR1	ASX340AT2C00XPED0-KY-DRBR	MT9V111IA7ATC-DR1
MT9V126IA3XTC-DR1	AR0331SRSC00SUCA0-DRBR1	AR0331SRSC00SHCA0-DRBR1
MT9J003I12STCU-DR	AR0130CSSC00SPCA0-DRBR1	MT9J003I12STMU-DP

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: *The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



製品速報

文書番号: PB23502Z

発行日: 08 Aug 2020

変更件名:	Kingpak における iBGA パッケージ用のパッケージ基板ベンダーとして UMTC を追加	
発効日:	08 Aug 2020	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所また Geethakrishnan.Narasimhan@onsemi.com にお問い合わせください。	
通知種別:	本製品速報は通知目的のみのものです。オン・セミコンダクターは本製品速報の発行により本変更を実行します。	
変更カテゴリ:	組立の変更	
変更サブカテゴリ:	パッケージ基板の代替サプライヤ	
影響を受ける拠点:		
オン・セミコンダクター拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点:	
なし	Kingpak, Taiwan	
説明および目的:		
オン・セミコンダクター インテリジェント・センシング・グループは KingPak が提供する当社の iBGA 用のパッケージ基板の供給拠点を追加します。		
この基板は既存の基板と同一の設計、材料、および構造であり、UMTC から供給されることになります。		
UMTC はオン・セミコンダクターの承認を得た基板サプライヤであり、車載用の認定サプライヤです。		
この変更は最終製品の完全性に影響を与えません。		
影響を受ける部品の一覧:		
注: 標準の部品番号(既製品)のみが部品一覧に記載されます。本 PCN に影響を受けるカスタム 部品は、PCN メールの顧客の特定の PCN の付属文書、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。		
AR0132AT6R00XPEA0-DRBR1	AR0132AT6G00XPEA0-AA-DRBR	ASX350AT3C00XPEA0-DR1
ARX550AT2C00XPEA0-DRBR	AR0136AT3C00XUEA0-DRBR	AR0144ATSM20XUEA0-DRBR
MT9M034I12STC-DRBR1	ASX340AT2C00XPED0-KY-DRBR	MT9V111IA7ATC-DR1
MT9V126IA3XTC-DR1	AR0331SRSC00SUCA0-DRBR1	AR0331SRSC00SHCA0-DRBR1
MT9J003I12STCU-DR	AR0130CSC00SPCA0-DRBR1	MT9J003I12STMU-DP